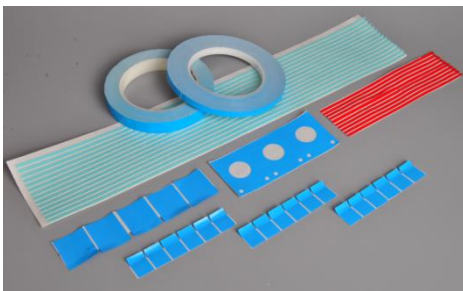


导热双面胶

【产品概述 Product Description】

SA410FG 导热双面胶, 大量应用于粘接散热片到微处理器和其它的功率消耗半导体上, SA410FG 导热双面胶具有极强的粘合强度, 并且热阻抗小, 可以有效的取代硅脂和机械固定。

【产品图示 Product Illustration】



【产品用途】

- 高强粘性适用于各种表面
- 双面压敏粘接胶带
- 高导热压克力粘胶
- 可承受长期的高温工作环境

【典型应用】

- LED 照明产品
- 底盘、框架或其他散热组件
- 大容量驱动器、热管组件
- RDRAM 记忆存储器
- 高频微处理芯片
- 笔记本和台式电脑

【储存&运输】 贮存于通风、阴凉、干燥处, 不要接触明火。本产品无毒, 按非危险品贮存及运输

【包装】 根据客户需求定制包装

【有效期】 本产品有效期为 12 个月

【安全】 请参阅本公司《材料安全性能数据 (MSDS) 》

以上这些建议及数据均来自我们认为可靠的资料。虽然是以诚信提供, 但由于我们无法控制产品的使用条件和方法, 无法对兼容性的应用提出任何建议, 因此这些建议及数据仅供参考, 而不作为产品保证。在任何时候, 应由用户最终决定他们的生产线是否能够有效地使用。应由买方决定产品是否合适或适用特殊用途。不保证产品质量或适用性可满足任何特殊用途。我们建议潜在用户在大量使用前, 首先确定我们的材料适用性和建议。

| 特性参数 SA410FG | | |
|---|---------------|------------|
| 颜色 | 白色 | 目视 |
| 基材 | 丙烯酸脂(亚克力) | *** |
| 基材加强 | 玻纤网 | *** |
| 厚度 (mm) | 0.25±0.01 | ASTM D374 |
| 击穿电压 (V) | >4600 | ASTM D149 |
| 剥离力 (kg/mm) | 2.5/25 | PSTC-3 |
| 持粘性 (KG/砵码)/时间 48H | 1.0 | *** |
| 初粘性 (球) | ≥14# | *** |
| 剪切强度 1.0 kg loading on 25 mm x 25 mm | > 48 hrs | PSTC-7 |
| 耐热强度 0.5kg loading on 25mm x 25mm at 80°C | > 24 hrs | *** |
| 导热系数 (W/m-k) | 1.0 | ASTM D5470 |
| 使用温度 | -30°C ~ 130°C | *** |
| 储存寿命 | 6 个月 | *** |
| 使用寿命 | 36 个月 | *** |
| RoHS | PASS | IEC 62321 |
| Halogen | PASS | EN14582 |
| REACH | PASS | EN14372 |

使用 ASTM D5470 测试夹具。记录值包括界面热阻。这些数值仅供参考。实际应用性能直接关系到所施加的表面粗糙度、平整度和压力。

注: 厚度公差为±10%, 硬度公差为±5%, 颜色/厚度/硬度均可按客户需求调试。